



DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets ⁵ : H01L 25/065, 23/49	A1	(11) Numéro de publication internationale: WO 94/25987 (43) Date de publication internationale: 10 novembre 1994 (10.11.94)
--	-----------	---

(21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR94/00427
(22) Date de dépôt international: 15 avril 1994 (15.04.94)
(30) Données relatives à la priorité:
93/04962 27 avril 1993 (27.04.93) FR
(71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): THOMSON-CSF [FR/FR]; 173, boulevard Haussmann, F-75008 Paris (FR).
(72) Inventeur; et
(75) Inventeur/Déposant (US seulement): VAL, Christian [FR/FR]; Thompson-CSF SCPI, Boîte postale 329, F-92402 Courbevoie Cédex (FR).
(74) Représentant commun: THOMSON-CSF SCPI; Boîte postale 329, F-92402 Courbevoie Cédex (FR).

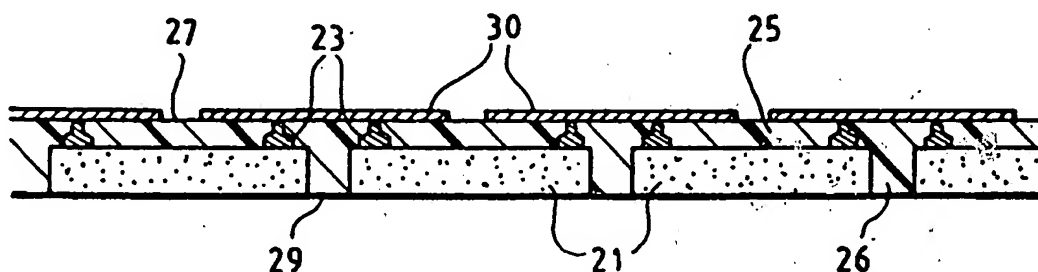
(81) Etats désignés: JP, US, brevet européen (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Publiée

Avec rapport de recherche internationale.

(54) Title: SEMICONDUCTOR CHIP ENCAPSULATION METHOD, DEVICE PRODUCED BY THIS METHOD AND ITS APPLICATION TO THREE DIMENSIONAL CHIP INTERCONNECTION

(54) Titre: PROCEDE D'ENCAPSULATION DE PASTILLES SEMI-CONDUCTRICES, DISPOSITIF OBTENU PAR CE PROCEDE ET APPLICATION A L'INTERCONNEXION DE PASTILLES EN TROIS DIMENSIONS



(57) Abstract

According to the method of the invention, conductive leads are directly wired onto a semiconductor wafer carrying a large number of chips, the wafer is bonded to a resilient film and cut to separate each chip, after which the film is stretched to space the chips; the totality of the chips and leads are then held in an insulating material such as a polymerizable resin, and, after polishing, metal plating is applied over the leads to connect them to the sides of the chips; the assembly is then cut in order to separate the chips.

(57) Abrégé

Selon le procédé de l'invention, on câble des fils conducteurs directement sur une rondelle semi-conductrice portant un grand nombre de pastilles, on colle la rondelle sur un film élastique, on scie la rondelle pour individualiser les pastilles puis on étire le film de sorte à écarter les pastilles; on solidarise ensuite l'ensemble des pastilles et des fils dans un matériau isolant, résine polymérisable par exemple, puis, après polissage, on réalise des dépôts métalliques au-dessus des fils de sorte à relier ceux-ci aux côtés des pastilles; on découpe ensuite l'ensemble de façon à séparer les pastilles.

UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AT	Autriche	GB	Royaume-Uni	MR	Mauritanie
AU	Australie	GE	Géorgie	MW	Malawi
BB	Barbade	GN	Guinée	NE	Niger
BE	Belgique	GR	Grèce	NL	Pays-Bas
BF	Burkina Faso	HU	Hongrie	NO	Norvège
BG	Bulgarie	IE	Irlande	NZ	Nouvelle-Zélande
BJ	Bénin	IT	Italie	PL	Pologne
BR	Brésil	JP	Japon	PT	Portugal
BY	Bélarus	KE	Kenya	RO	Roumanie
CA	Canada	KG	Kirghizistan	RU	Fédération de Russie
CF	République centrafricaine	KP	République populaire démocratique de Corée	SD	Soudan
CG	Congo	KR	République de Corée	SE	Suède
CH	Suisse	KZ	Kazakhstan	SI	Slovénie
CI	Côte d'Ivoire	LI	Liechtenstein	SK	Slovaquie
CM	Cameroun	LK	Sri Lanka	SN	Sénégal
CN	Chine	LU	Luxembourg	TD	Tchad
CS	Tchécoslovaquie	LV	Lettonie	TG	Togo
CZ	République tchèque	MC	Monaco	TJ	Tadjikistan
DE	Allemagne	MD	République de Moldova	TT	Trinité-et-Tobago
DK	Danemark	MG	Madagascar	UA	Ukraine
ES	Espagne	ML	Mali	US	Etats-Unis d'Amérique
FI	Finlande	MN	Mongolie	UZ	Ouzbékistan
FR	France			VN	Viet Nam
GA	Gabon				

**PROCEDE D'ENCAPSULATION DE PASTILLES SEMI-CONDUCTRICES,
DISPOSITIF OBTENU PAR CE PROCEDE ET APPLICATION
A L'INTERCONNEXION DE PASTILLES EN
TROIS DIMENSIONS**

5

La présente invention a pour objet un procédé d'encapsulation de
10 pastilles semi-conductrices ainsi que le dispositif en résultant, chacune des
pastilles contenant par exemple un composant électronique, un circuit
intégré ou un capteur. Elle a également pour objet l'application d'une telle
encapsulation à l'interconnexion en trois dimensions de ces pastilles.

15 La réalisation des systèmes électroniques actuels, tant civils que
militaires, doit tenir compte d'exigences de plus en plus grandes de
compacité, du fait du nombre de plus en plus élevé de circuits mis en
oeuvre.

En ce sens, il a déjà été proposé de réaliser des empilements de
20 circuits intégrés dits "trois dimensions", comme par exemple décrit dans la
demande de brevet français n° 2.670.323 au nom de THOMSON-CSF. Selon
cette réalisation, les pastilles sont empilées après avoir été munies de fils de
connexion orientés vers les faces latérales de l'empilement, puis elles sont
rendues solidaires les unes des autres, à l'aide par exemple d'une résine ;
25 les interconnexions des pastilles sont ensuite réalisées sur les faces de
l'empilement.

La présente invention a pour but de modifier ce processus
notamment pour en rendre la réalisation plus facilement intégrable dans une
30 usine de semi-conducteurs et en diminuer le coût.

Plus précisément, selon le procédé de l'invention, on câble des
conducteurs, fils par exemple, directement sur une rondelle semi-
conductrice portant un grand nombre de pastilles ; la rondelle étant collée
sur un film élastique, on scie la rondelle pour individualiser les pastilles puis
35 on tire le film de sorte à écarter les pastilles ; on solidarise ensuite

l'ensemble des pastilles et des fils dans un matériau isolant, résine polymérisable par exemple, puis, après polissage, on réalise des dépôts métalliques au-dessus des fils de sorte à relier ceux-ci aux côtés des pastilles ; on découpe ensuite l'ensemble de façon à séparer les pastilles :

5 on obtient alors des pastilles encapsulées dans un enrobage formant boîtier, muni de connexions. Pour une application "trois dimensions", on procède à l'empilement des boîtiers précédents, ceux-ci étant simplement collés entre eux à l'aide d'un intercalaire disposé entre chaque pastille et la suivante,

10 l'empilement ainsi obtenu, par exemple comme décrit dans la demande de brevet précitée.

D'autres objets, particularités et résultats de l'invention ressortiront de la description suivante, donnée à titre d'exemple et illustrée par les

15 dessins annexés, qui représentent :

- la figure 1, un mode de réalisation du procédé selon l'invention ;
- les figures 2 à 4a et 5, différents schémas vus en coupe, illustrant différentes étapes du procédé selon l'invention ;
- la figure 4b, une vue de dessus du schéma de la figure 4a ;
- 20 - les figures 6 et 7, des vues en coupe schématiques de variantes de l'invention.

Sur ces différentes figures, les mêmes références se rapportent aux mêmes éléments. D'autre part, pour la clarté des dessins, l'échelle réelle n'a pas été respectée.

25

La figure 1 représente donc un mode de réalisation du procédé selon l'invention.

La première étape, repérée 10, consiste à fixer (par exemple coller), sur un film élastique, une rondelle de matériau semi-conducteur (également

30 connue sous le nom anglais de "wafer"), dans laquelle on a réalisé un grand nombre de pastilles (couramment de l'ordre de plusieurs centaines), contenant chacune un circuit intégré ou composant discret ; le film est par exemple un auto-adhésif de type polymère.

La deuxième étape, repérée 11, consiste à câbler des conducteurs électriques, fils ou rubans, sur chacun des plots de connexion de chacune des pastilles contenues dans la rondelle.

Le résultat de ces opérations est illustré sur la figure 2.

- 5 Sur cette dernière figure, on a représenté une rondelle semi-conductrice 1 dans laquelle on a identifié une pastille 21. La rondelle 1 est montée sur le film élastique, repéré 2. Sur chacun des plots, repérés 22, de la rondelle 1 sont connectés des conducteurs 23, par exemple des fils. Ceux-ci peuvent être connectés verticalement à l'aide de la technique dite
- 10 "ball bonding" et consistant à faire fondre l'extrémité du fil 23 pour obtenir une petite boule 24, facilitant sa connexion sur le plot 22. D'autres techniques peuvent être employées, comme illustré par exemple ci-après figure 7. Après leur fixation, les fils 23 sont coupés chacun à une hauteur prédéterminée, qui peut être par exemple de 150 à 200 μm , pour un
- 15 diamètre de fil d'environ 25 à 30 μm , une épaisseur de rondelle de l'ordre de 500 μm et de film 2 de l'ordre de 200 μm , par exemple.

- L'étape suivante (12, figure 1) consiste à scier la rondelle 2 de préférence sur toute son épaisseur, de sorte à individualiser les pastilles
- 20 telles que 21.

L'étape suivante, repérée 13, consiste à étirer uniformément le film élastique (2); cela a pour effet d'écarter les pastilles (21) les unes des autres et, ce, de façon régulière.

- 25 Il est à noter que l'étape 11 de câblage des fils sur la rondelle (1) peut être, dans une variante de réalisation, effectuée seulement après cette étape 13 d'étirement du film élastique (2).

- L'étape suivante, repérée 14, consiste à solidariser les pastilles et
- 30 leurs fils de connexion et enrober le tout dans un matériau électriquement isolant, par exemple une résine organique, époxy ou polyimide, par une technique de coulage ou de moulage par exemple, le matériau étant ensuite, le cas échéant, polymérisé.

Le résultat de cette étape est illustré sur la figure 3.

Sur cette figure, on retrouve le film 2 portant des pastilles 21, maintenant individualisées et séparées les unes des autres. Les pastilles 21 et leurs conducteurs 23 sont noyés dans un matériau isolant 25, qui pénètre également dans les intervalles 26 entre pastilles.

5

L'étape suivante, repérée 15, consiste à polir la face supérieure (27, figure 3) du matériau d'enrobage 25, de sorte à obtenir une surface plane sur laquelle les sections des fils 23 affleurent.

L'épaisseur du matériau d'enrobage 25 dépend de celle de la
10 rondelle 1 et des matériaux concernés, notamment pour des raisons thermo-mécaniques. A titre d'exemple, pour une rondelle de 400 à 500 μm d'épaisseur, le matériau 25 peut faire environ 150 μm .

L'étape suivante (16, figure 1) consiste à supprimer le film élastique
15 2.

Cette suppression peut être réalisée par exemple par décollage du film. Dans une variante de réalisation, on procède à un polissage de la face arrière de l'ensemble, repéré 28 sur la figure 3, c'est-à-dire la face opposée à la face 27 pour supprimer le film 2 et/ou amincir les pastilles 21 dans le but
20 d'en réduire l'épaisseur et l'encombrement, ce qui peut être particulièrement avantageux dans l'application décrite ci-après d'empilement des pastilles encapsulées en trois dimensions.

Dans une variante de réalisation, on ne supprime pas le film élastique 2 qui permet alors d'isoler et/ou de protéger la face arrière 28 de la
25 pastille.

L'étape suivante, repérée 17, consiste à réaliser des connexions reliant chacun des conducteurs 23 à ce qui deviendra la face latérale des pastilles après séparation, ces connexions étant réalisées par métallisations
30 sur la face supérieure 27 au dessus de l'intervalle inter-pastilles.

Les figures 4a et 4b illustrent cette étape, vue respectivement en coupe et de dessus.

La figure 4a représente les pastilles 21 avec leurs fils 23 noyés dans le matériau 25. La face supérieure 27 de l'ensemble porte des métallisations

30 au-dessus des fils 23, métallisations qui relient chacun des fils 23 à l'intervalle 26 entre pastilles.

Ces métallisations peuvent affecter différentes formes comme illustré sur la vue de dessus de la figure 4b : elles peuvent relier un fil 23 à la zone inter-pastille 26, relier ensemble deux fils 23 de pastilles différentes ou relier en outre un fil 23 à une zone 31, utilisée ultérieurement pour le test des pastilles par exemple.

La réalisation des connexions 30 peut être faite par tout moyen connu, par exemple dépôt d'une couche métallique et gravure ultérieure de cette couche. Le dépôt peut être un dépôt métallique tel que or, nickel et or, nickel-cuivre et or, cuivre et or, effectué par exemple sous vide par pulvérisation cathodique, éventuellement rechargé par voie électrochimique. La gravure ultérieure peut être par exemple une photogravure. Dans une variante, on peut utiliser une photogravure dite inverse, c'est-à-dire laissant le métal partout sauf autour des conducteurs, celle-ci permettant de réaliser en outre un blindage électromagnétique.

La dernière étape de la réalisation des pastilles encapsulées (étape 18, sur la figure 1) consiste en la séparation des pastilles. Cette séparation est réalisée par découpe du matériau 25 entre les pastilles, par exemple à l'aide d'une scie diamantée. On obtient alors des pastilles semi-conductrices enrobées chacune sur cinq de leurs faces dans un matériau isolant formant boîtier, ce dernier étant muni de connexions (métallisations 30), testable et manipulable.

25

Lorsqu'on veut réaliser avec des pastilles ainsi encapsulées un empilement en trois dimensions (étape 19, figure 1), on dispose les boîtiers dans une glissière permettant d'aligner deux des faces latérales des boîtiers, simplifiant ainsi les problèmes de positionnement relatif des boîtiers. Entre les boîtiers sont disposées des couches de matériau adhésif, tel qu'une résine polymérisable par exemple. On presse ensuite l'ensemble et éventuellement on le polymérise, de sorte à le solidariser.

Ceci est illustré sur la figure 5 où on retrouve les pastilles 21 et leur matériau d'enrobage 25, séparés les uns des autres par une couche adhésive 32. Dans une variante de réalisation, on utilise, pour le film

35

élastique 2, un matériau adhésif -ou rendu adhésif par un traitement approprié- qu'on laisse en place, évitant ainsi l'interposition des couches 32.

Sur chacune des faces extrêmes de l'empilement, on dispose en outre une couche de fermeture 42 non adhésive, qui est fixée par l'intermédiaire d'une
5 couche 32. Dans une variante de réalisation (non représentée), les couches de fermeture 42 peuvent être adhésives sur l'une de leurs faces, évitant ainsi la couche 32. Les métallisations 30 relient chacun des conducteurs 23 vers la tranche 35 de l'empilement.

10 L'étape suivante (20, figure 1) consiste à interconnecter entre elles les différentes pastilles de l'empilement et à les relier, le cas échéant, à des plots, dits plots d'empilement, permettant leur connexion à des circuits extérieurs. Ces interconnexions sont réalisées sur les faces de l'empilement, par exemple comme décrit dans la demande de brevet français précitée.

15 Sur la figure 5, on a représenté à titre d'exemple les différentes connexions 30 toutes reliées entre elles à l'aide d'une métallisation 33 disposée sur la face de l'empilement et se prolongeant (34) par exemple sur l'une ou sur les deux des faces extrêmes de l'empilement. Dans ce dernier cas, l'une des faces peut être utilisée pour le test alors que l'autre est
20 utilisée pour le montage de l'empilement sur un circuit imprimé par exemple.

Dans une autre variante de réalisation (non représentée), on peut réaliser en même temps plusieurs empilements, ceux-ci étant éventuellement séparés les uns des autres en outre par un intercalaire non adhésif. Les interconnexions des pastilles par les faces latérales de
25 l'empilement peuvent alors être réalisées de façon collective, simultanément pour tous les empilements.

Dans une autre variante de réalisation, on peut améliorer le refroidissement des pastilles en fonctionnement par l'insertion de drains
30 thermiques entre les boîtiers, reliés éventuellement à un radiateur.

Dans l'exemple représenté sur la figure 6, on retrouve les pastilles 21, leurs conducteurs 23 et le matériau d'enrobage 25. Les connexions 30 liant les fils 23 à l'une des faces latérales de la pastille sont dirigées de sorte à dégager l'une de ces faces, par exemple la face gauche sur la figure. Un
35 drain thermique 38, couche métallique par exemple, en cuivre ou nitrure

d'aluminium, ou encore en diamant, est disposé entre chaque pastille 21 par l'intermédiaire d'une couche de colle 36. La face latérale gauche de l'empilement est par exemple collée, par l'intermédiaire d'une couche de colle 39, de préférence thermiquement conductrice, à un radiateur 37, lequel se trouve ainsi en contact thermique avec les drains 38. Pour la clarté du schéma, les couches de colle 36 n'ont pas été hachurées bien que vues en coupe.

La figure 7 représente, vue en coupe, une variante de réalisation de l'étape 11 de la figure 1, à savoir le câblage de conducteurs sur la rondelle.

Sur cette figure, on retrouve la rondelle 1 montée sur son film élastique 2 et portant des plots 22, sur lesquels on souhaite câbler des conducteurs 23. Selon cette variante, on munit la face supérieure de la rondelle 1 de morceaux de substrat du type circuit imprimé 39, de préférence au moins un par pastille, le circuit imprimé 39 étant fixé sur la rondelle à l'aide par exemple d'une couche de colle 40. Le circuit imprimé 39 porte au moins une métallisation 41. Selon cette variante, le conducteur 23 n'est plus coupé mais il est courbé de sorte à être connecté de plus à la métallisation 41 portée par le circuit imprimé 39. En outre, le conducteur 23 peut être connecté verticalement sur le plot 22 comme représenté sur les figures précédentes ou bien comme représenté sur la figure 7, connecté horizontalement comme sur la métallisation 41.

Toutes les opérations ultérieures du procédé selon l'invention se déroulent de la même manière, le conducteur 23 étant coupé lors du polissage du matériau d'enrobage (étape 15) de sorte à venir affleurer comme précédemment sur la face supérieure de la pastille.

Le procédé décrit ci-dessus, ainsi que les dispositifs obtenus, présentent un certain nombre d'avantages parmi lesquels le fait qu'il est possible de traiter un grand nombre de pastilles simultanément (toutes celles qui appartiennent à une même rondelle) et, ce, avec des techniques connues dans l'industrie des semi-conducteurs, facilement intégrables dans une chaîne de production de circuits semi-conducteurs, ce qui diminue considérablement le coût de la pastille encapsulée et qui permet, de par les techniques utilisées, d'obtenir des dimensions très réduites, notamment par

le matériau d'enrobage, qui peut représenter typiquement un accroissement de l'aire (de la pastille) de moins de 1%. En outre, le mode d'encapsulation est bien adapté à un empilement "trois dimensions", réalisable collectivement et simplement, avec les avantages de coût qui en découlent.

REVENDICATIONS

1. Procédé d'encapsulation de pastilles semi-conductrices, caractérisé par le fait qu'il comporte les étapes suivantes :
- 5 - câblage de conducteurs (23) sur les plots de connexion (22) des pastilles (21), celles-ci étant contenues dans une même rondelle (1) de matériau semi-conducteur ;
- sciage de la rondelle pour individualiser les pastilles, la rondelle étant fixée sur un film élastique (2) ;
- 10 - étirement du film élastique de sorte à séparer les pastilles ;
- solidarisation et enrobage des conducteurs et pastilles à l'aide d'un matériau (25) électriquement isolant ;
- polissage du matériau d'enrobage de sorte à faire affleurer les conducteurs ;
- 15 - réalisation sur le matériau d'enrobage de connexions (30) reliant les conducteurs aux côtés des pastilles ;
- séparation des pastilles.
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé par le fait que le
- 20 matériau d'enrobage (25) est une résine polymérisable.
3. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé par le fait qu'il comporte en outre, après l'étape de polissage, une étape de suppression du film élastique (2).
- 25
4. Pastille semi-conductrice (21) comportant des plots de connexion (22), caractérisée par le fait qu'elle comporte des conducteurs (23) connectés sur ses plots, que la pastille et ses conducteurs sont enrobés d'un matériau isolant (25), de telle sorte que les conducteurs affleurent la
- 30 surface (27) du matériau isolant, et qu'elle comporte en outre sur cette dernière surface des connexions électriques (30) reliant les conducteurs aux côtés de la pastille.
5. Pastille selon la revendication 4, caractérisée par le fait que
- 35 chacun des conducteurs (23) est formé par un fil ou un ruban.

6. Procédé d'interconnexion de pastilles obtenues par le procédé selon la revendication 1, caractérisé par le fait qu'il comporte en outre les étapes suivantes :

- 5 - empilement des pastilles séparées et solidarisation de l'empilement ;
 - réalisation de l'interconnexion des connexions des pastilles sur les faces de l'empilement.

- 10 7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé par le fait que l'empilement des pastilles séparées est réalisé en disposant entre les pastilles une couche d'un matériau susceptible de les faire adhérer l'une à l'autre.

- 15 8. Dispositif comportant des pastilles selon la revendication 4, caractérisé par le fait que les pastilles (21) sont empilées et séparées par une couche (2, 32) d'un matériau assurant leur adhérence mutuelle et qu'il comporte en outre des interconnexions (33) portées par les faces de l'empilement, interconnectant les connexions (30) des pastilles.

1/5

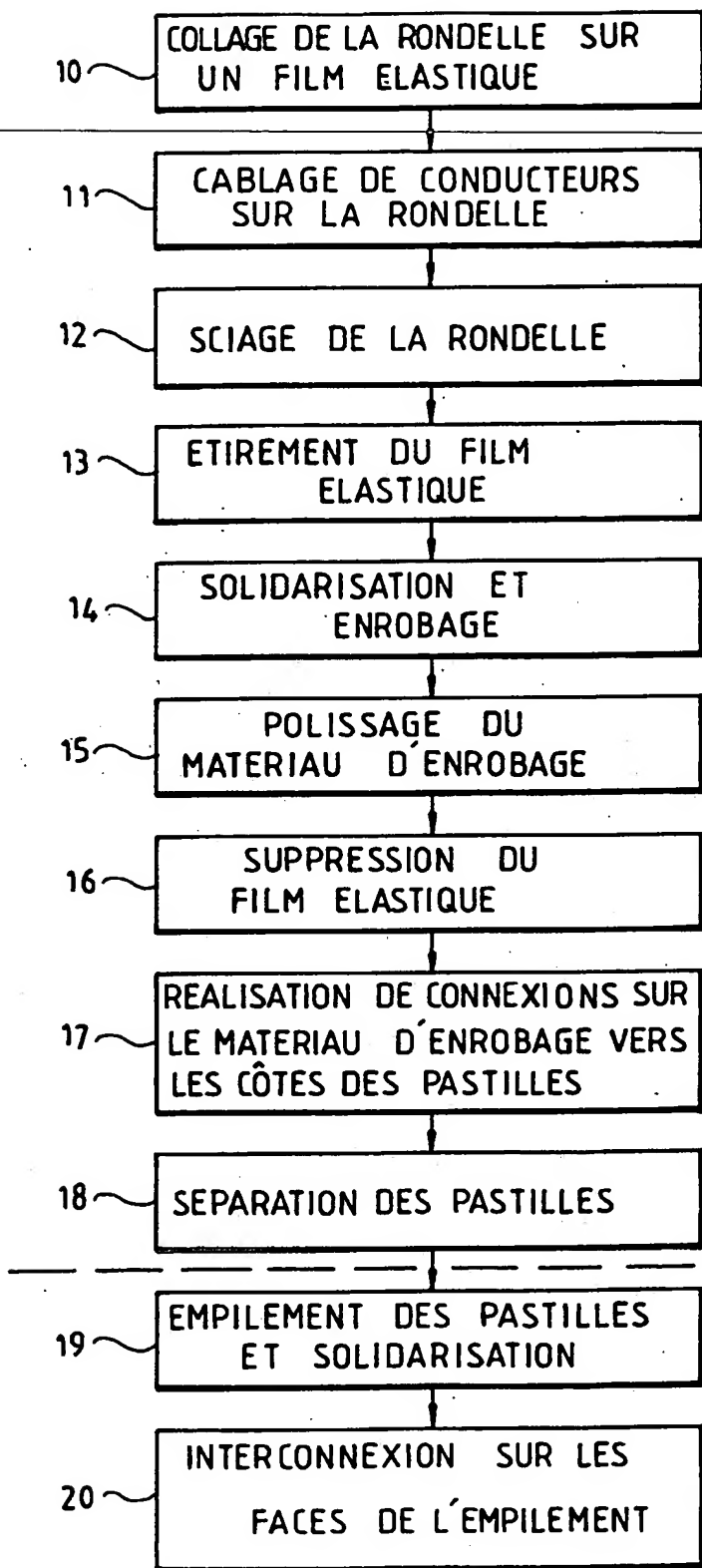


FIG.1

FEUILLE DE REMPLACEMENT (REGLE 26)

2/5

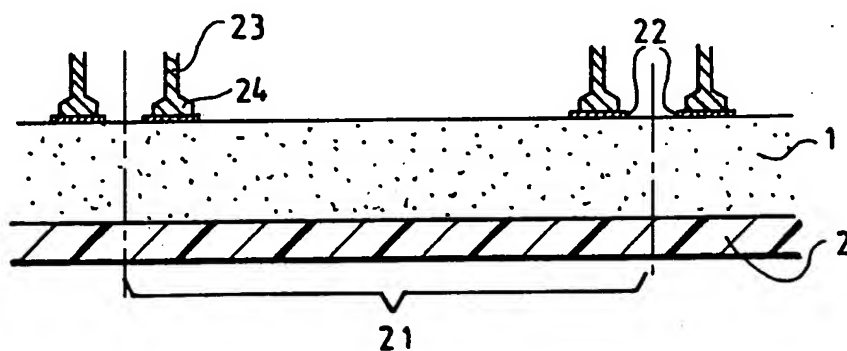


FIG. 2

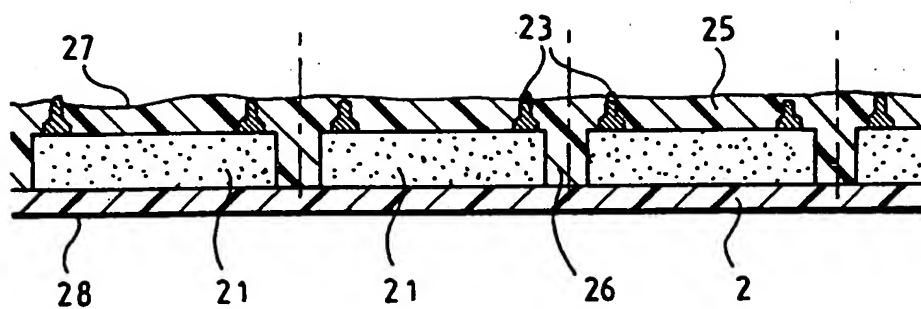


FIG. 3

3/5

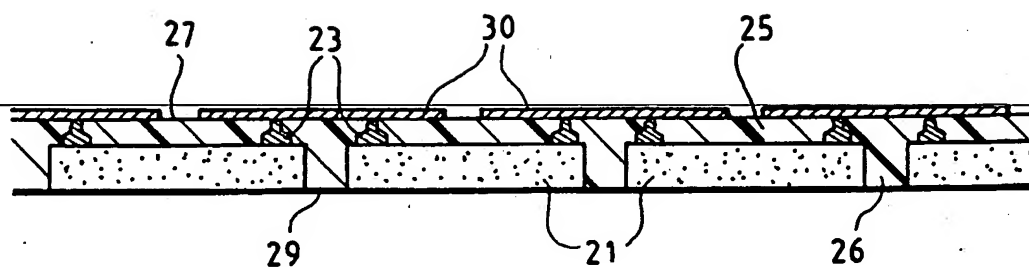


FIG. 4a

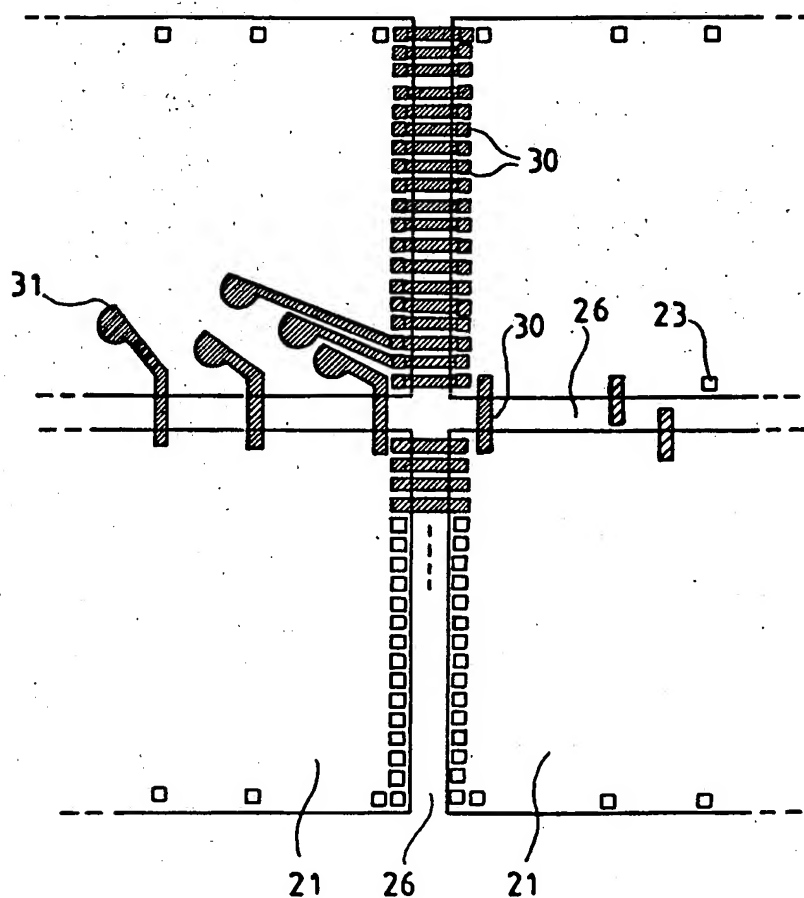


FIG. 4b

FEUILLE DE REMPLACEMENT (REGLE 26)

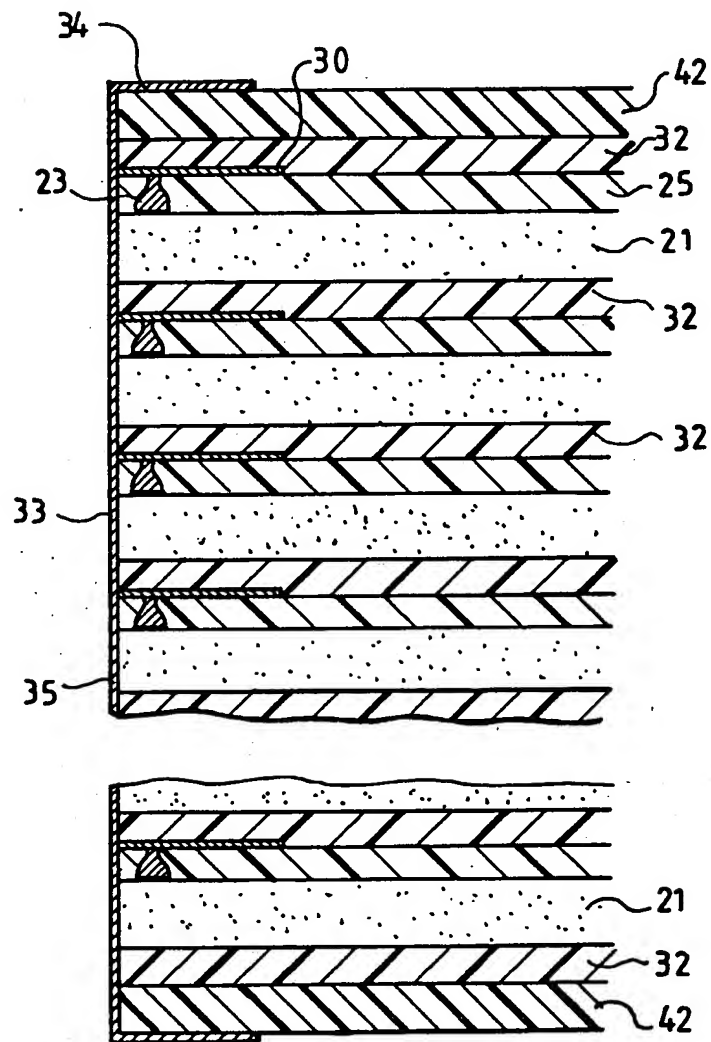


FIG.5

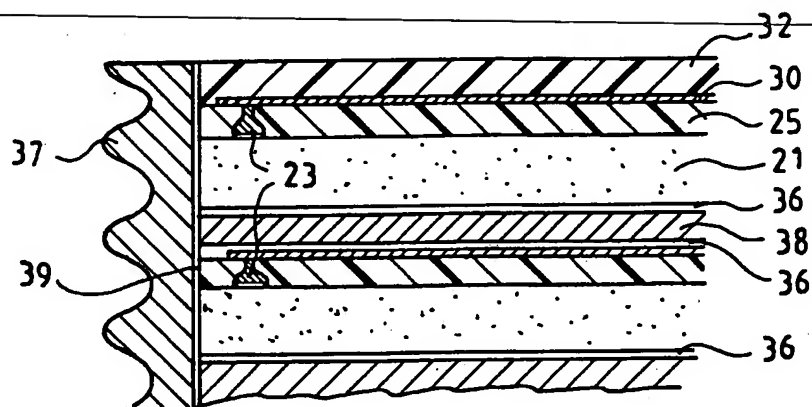


FIG. 6

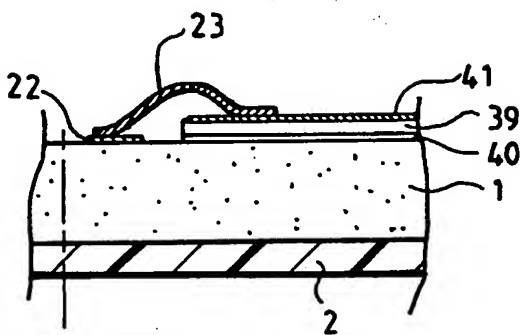


FIG. 7

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/FR 94/00427

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 5 H01L25/065 H01L23/49

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 5 H01L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	FR,A,2 645 681 (THOMSON-CSF) 12 October 1990 see the whole document ---	1-8
A	11th IEEE/CHMT Intl.Electronics Manufacturing Technology Symposium, San Francisco, USA, September 16-18, 1991, p. 80-84, C. MEISSER: "Modern Bonding Processes for Large-Scale Integrated Circuits, Memory Modules and Multichip Modules in Plastic Packages" see the whole document ---	1-8
A	WO,A,90 11629 (CRAY RESEARCH, INC.) 4 October 1990 see the whole document --- -/--	1-8

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

17 June 1994

Date of mailing of the international search report

0 6. 07. 94

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Prohaska, G

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/FR 94/00427

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO,A,91 00619 (RAYCHEM CORPORATION) 10 January 1991 see the whole document	1-8
A	WO,A,92 17901 (INTEGRATED SYSTEMS ASSEMBLIES CORPORATION) 15 October 1992 see the whole document	
A	DE,A,37 19 742 (SIEMENS) 29 December 1988 see abstract; figures	
A	EP,A,0 257 119 (IBM) 2 March 1988 see figures	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

International Application No

PCT/FR 94/00427

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
FR-A-2645681	12-10-90	NONE	
WO-A-9011629	04-10-90	US-A- 5098305 AU-A- 4313389	24-03-92 22-10-90
WO-A-9100619	10-01-91	US-A- 5195237	23-03-93
WO-A-9217901	15-10-92	AU-B- 648417 AU-A- 1874392 CA-A- 2106872 EP-A- 0577779 JP-T- 6502744 US-A- 5250843	21-04-94 02-11-92 28-09-92 12-01-94 24-03-94 05-10-93
DE-A-3719742	29-12-88	NONE	
EP-A-0257119	02-03-88	JP-C- 1612405 JP-B- 2040219 JP-A- 63053960 US-A- 4802062	30-07-91 10-09-90 08-03-88 31-01-89

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Dem Internationale No
PCT/FR 94/00427A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE
CIB 5 H01L25/065 H01L23/49

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 5 H01L

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de recherche utilisés)

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	FR,A,2 645 681 (THOMSON-CSF) 12 Octobre 1990 voir le document en entier ---	1-8
A	11th IEEE/CHMT Intl.Electronics Manufacturing Technology Symposium, San Francisco, USA, September 16-18, 1991, p. 80-84, C. MEISSER: "Modern Bonding Processes for Large-Scale Integrated Circuits, Memory Modules and Multichip Modules in Plastic Packages" voir le document en entier ---	1-8
A	WO,A,90 11629 (CRAY RESEARCH, INC.) 4 Octobre 1990 voir le document en entier ---	1-8
-/-		

☒ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents☒ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

* Catégories spéciales de documents cités:

- "A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
- "E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date
- "L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- "O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
- "P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

- "T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention
- "X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément
- "Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier
- "&" document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

17 Juin 1994

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

06.07.94

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale
Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Prohaska, G

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Dem Internationale No
PCT/FR 94/00427

C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	WO,A,91 00619 (RAYCHEM CORPORATION) 10 Janvier 1991 voir le document en entier ---	1-8
A	WO,A,92 17901 (INTEGRATED SYSTEMS ASSEMBLIES CORPORATION) 15 Octobre 1992 voir le document en entier ---	
A	DE,A,37 19 742 (SIEMENS) 29 Décembre 1988 voir abrégé; figures ---	
A	EP,A,0 257 119 (IBM) 2 Mars 1988 voir figures -----	

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE
Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Dem Internationale No
PCT/FR 94/00427

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
FR-A-2645681	12-10-90	AUCUN	
WO-A-9011629	04-10-90	US-A- 5098305 AU-A- 4313389	24-03-92 22-10-90
WO-A-9100619	10-01-91	US-A- 5195237	23-03-93
WO-A-9217901	15-10-92	AU-B- 648417 AU-A- 1874392 CA-A- 2106872 EP-A- 0577779 JP-T- 6502744 US-A- 5250843	21-04-94 02-11-92 28-09-92 12-01-94 24-03-94 05-10-93
DE-A-3719742	29-12-88	AUCUN	
EP-A-0257119	02-03-88	JP-C- 1612405 JP-B- 2040219 JP-A- 63053960 US-A- 4802062	30-07-91 10-09-90 08-03-88 31-01-89